

无锡芯朋微电子股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 7 月 24 日以通讯方式召开。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司及全资子公司综合授信额度的议案》

近日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕PDFI14 号），交易商协会决定接受公司债务融资工具注册。为保障首次发债顺利完成，公司增加合作银行范围，并拟向银行等金融机构增加申请人民币 50 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。上述授权有效期为自第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 25 日